

2023年9月5日

## エレクトロニクス製造・実装技術展「ネプコンジャパン」へ初出展

－食品・メディカル包装の実績を基に電子部材包装の重要性を提唱－

食品やメディカル分野の包装で世界的な実績を誇る MULTIVAC 社（本社：ドイツ）の日本法人であるマルチバック・ジャパン（本社：東京都中央区、社長：大沼謙一郎）は、電子部材の自動包装においてもその専門知識と革新的なアプローチ手法を紹介することを目的に、エレクトロニクス製造・実装技術展「第2回 ネプコンジャパン [秋]」へ初めて出展します。

電子部材の自動包装は、製造工程における業務の効率化と品質保持のために不可欠な要素です。マルチバック・ジャパンはこれまでの食品やメディカル分野での包装分野で培った経験を活かし、電子部材に特有の課題に対する自動化ソリューションを提案いたします。

### マルチバック・ジャパンの電子部材包装自動化における提案ポイント

#### 1. 業務の効率化:

現代の製造業界では、人手不足と生産性の向上が大きな課題です。包装の自動化はこれらの問題に対処する重要な手段です。マルチバック・ジャパンの自動化システムは作業プロセスを省人化・効率化し、人的エラーを最小限に抑えることで、業務の効率化を実現します。また、生産性の向上と品質の一貫性を確保することにも貢献します。

#### 2. 品質保持:

電子部材は繊細で外部の影響に弱いいため、適切な包装が不可欠です。マルチバック・ジャパンの自動化包装システムは、特殊な包装材料と精密な制御技術を組み合わせることで、電子部材の品質を確実に保つとともに、防電、防振、防錆、防湿といった保護も提供します。

#### 3. 環境への配慮:

自動化包装システムは過剰包装を防ぎ、廃棄物の削減に貢献します。マルチバック・ジャパンは、持続可能な包装ソリューションを提供することで、環境保護に寄与します。

### マルチバック・ジャパン出展内容

- ・ 全自動深絞り包装機
- ・ チャンバー式包装機
- ・ 包装材料（電子部品包装）

## 第2回 ネプコンジャパン [秋]

【会期】 2023年9月13日(水)～9月15日(金)

【時間】 10:00～17:00

【会場】 幕張メッセ

【ブース】 No.6-50

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

### 【会社概要】

会社名：マルチバック・ジャパン株式会社

本社：東京都中央区銀座5-9-8 クロス銀座ビル5F

社長：大沼謙一郎

設立：1973年2月16日

従業員数：186人（2023年4月）

事業内容：食品、メディカル関連製品、化成品の加工機械・包装機械の輸入及び包装資材の販売

ホームページ：<https://multivac-jp.com/>

### メディアに関するお問い合わせ先:

マルチバック・ジャパン株式会社 展示会・営業支援（広報担当）

電話：03-6264-6408

MAIL：[info@jp.multivac.com](mailto:info@jp.multivac.com)